

Bruxelles, 9 settembre 2025 (OR. en)

12656/25 ADD 1

ENV 815 MI 635 DELACT 125

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data: Destinatario:	8 settembre 2025 Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 5939 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della direttiva delegata della Commissione che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 5939 final - Annex.

All.: C(2025) 5939 final - Annex

12656/25 ADD 1 TREE.1.A



Bruxelles, 8.9.2025 C(2025) 5939 final

ANNEX

ALLEGATO

della

direttiva delegata della Commissione

che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione

IT IT

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 7 a) è sostituita dalla seguente:

"7 a)	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso)	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 30 giugno 2027.
7 a)-I	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) per le interconnessioni interne per il fissaggio della matrice, o per altri componenti con la matrice nell'assemblaggio dei semiconduttori con correnti stazionarie, transitorie o impulsive pari o superiori a 0,1 A, o con tensione di blocco superiore a 10 V, o dimensioni del bordo della matrice superiori a 0,3 mm x 0,3 mm.	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-II	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) per le connessioni integrali (vale a dire interne ed esterne) del fissaggio della matrice nei componenti elettrici ed elettronici, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: - la conduttività termica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a <i>curing</i> /sinterizzazione è > 35 W/(m*K), - la conduttività elettrica del materiale di fissaggio della matrice sottoposto a <i>curing</i> /sinterizzazione è > 4,7 MS/m, - la temperatura di solidus è superiore a 260 °C	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-III	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) nei giunti di saldatura di primo livello (connessioni interne o integrali, vale a dire interne ed esterne) per la fabbricazione di componenti, in modo che il	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il

	·	
	successivo montaggio di componenti elettronici su sottounità (ossia moduli, pannelli di sottocircuiti, substrati o saldature punto a punto) con una saldatura di secondo livello non causi la rifusione della saldatura di primo livello. Questa sottovoce esclude le applicazioni di fissaggio della matrice e le sigillature ermetiche	31 dicembre 2027.
7 a)-IV	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) nei giunti di saldatura di secondo livello per il fissaggio di componenti alle schede a circuito stampato o ai <i>lead frame</i> : 1. in sfere per saldature per il fissaggio di <i>ball-grid-array</i> (BGA) in ceramica 2. in sovrastampaggi di plastica ad alta temperatura (> 220 °C)	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-V	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) come materiale per la sigillatura ermetica tra: 1. un package o una spina di ceramica e un contenitore metallico 2. le terminazioni dei componenti e una sottoparte interna.	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-VI	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) per stabilire connessioni elettriche tra i componenti delle lampade con riflettore a incandescenza per il riscaldamento a infrarossi, le lampade a scarica ad alta intensità o le lampade da forno	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027.
7 a)-VII	Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso) per i trasduttori audio con temperatura massima di funzionamento superiore a 200 °C	Si applica a tutte le categorie (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 24 del presente allegato) e scade il 31 dicembre 2027."